

**HST-H3 热封试验仪**采用热压封口法测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其它热封复合膜的热封温度、热封时间、热封压力等参数。熔点、热稳定性、流动性及厚度不同的热封材料，会表现出不同的热封性能，其封口工艺参数可能差别很大。热封试验仪通过其标准化的设计、规范化的操作，可获得精确的热封试验指标。



## 专 业

HST-H3 热封试验仪基于热压封口测试方法，采用按照国家及国际标准规定设计的热压封头，专业用于测定各种热封复合膜的热封温度、热封时间、以及热封压力等关键参数，进而指导大规模工业生产。

- 数字 P.I.D 控温技术不仅可以快速达到设定温度，还可以有效地避免温度波动
- 宽范围温度、压力和时间控制可以满足用户的各种试验条件
- 手动和脚踏两种试验启动模式以及防烫伤安全设计，可以有效保证用户使用的方便性和安全性
- 微电脑控制、液晶显示、PVC 操作面板、菜单式界面，方便用户快速操作
- 专业软件可以帮助用户远程操作，方便试验数据的存储、导出和打印

## 精 密

HST-H3 热封试验仪采用了精密的机械设计，铝罐封式的热封头保证了热封面加热的均匀性，气缸控制的热封头升降对热封面均匀施压，快速拔插式加热管接头方便用户即插即用。

- 铝罐封式的热封头保证了热封面均匀受热，试样不同位置的热封温度保持一致
- 下置式气缸设计不仅可以保证仪器在操作中的稳定性，还能有效避免因受热而引起的压力波动
- 快速拔插式的加热管电源接头方便用户随时拆卸

## 高 端

HST-H3 热封试验仪在 HST-H6 的基础上，增加了许多智能化配置，为高端用户提供了合适的选择。

- 上下热封头均可独立控温，为用户提供了更多的试验条件组合
- 下置式双气缸同步回路，进一步保证了热封面受压均匀性
- 加长的热封面可满足大面积试样或多试样同时封口，并支持多种热封面形式的定制
- 配置脚踏开关，保证用户的安全操作
- 配备 RS232 接口和专业控制软件，方便电脑连接和数据导入导出

## 测试原理

HST-H3 采用热压封口法，将待封试样置于上下热封头之间，在预先设定的温度、压力、和时间下，完成对试样的封口。

该仪器满足多种国家和国际标准：QB/T 2358、ASTM F2029、YBB 00122003

## 测试应用

基础应用	薄膜材料光滑平面	适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的热封试验，热封面为光滑平面，热封宽度可以根据用户的需求进行设计
	薄膜材料花纹平面	适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的热封试验，热封面可以根据用户的需求进行设计
扩展应用	果冻杯盖	把果冻杯放入下封头的开孔中，下封头的开孔和果冻杯的外径配合，杯口的翻边落在孔的边缘，上封头做成圆形，下压完成对果冻杯的热封（注：需定制配件）
	塑料软管	把塑料软管的管尾放在上下封头之间，对管尾进行热封，使塑料软管成为一个包装容器

## 技术指标

指标	参数
热封温度	室温~300℃
控温精度	±0.2℃
热封时间	0.1~999.9 s
热封压力	0.05 MPa~0.7 MPa
热封面	330 mm × 10 mm（可定制）
加热形式	单加热或双加热
气源压力	0.5 MPa~0.7 MPa（气源用户自备）
气源接口	Φ6 mm 聚氨酯管
外形尺寸	536 mm (L) × 335 mm (W) × 413 mm (H)
电源	220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz
净重	43 kg

◇ 对于用户有特殊需求的，我司在能力范围内可为用户进行定制化生产，以满足用户需求。

## 产品配置

标准配置	主机、脚踏开关
选购件	专业软件、通信电缆、微型打印机、专用打印线
备注	本机气源接口为 Φ6 mm 聚氨酯管；气源用户自备

◇ Labthink 始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知。本公司保留修改权与最终解释权。